

CUTTING EDGE

カッティングエッジ

80期中間事業のご報告

2018年4月1日～2018年9月30日

社長メッセージ



消耗品の売上高が最高を更新 上期の売上高は過去2番目の水準となりました。

事業環境・業績

2018年度上期、半導体メーカ各社の設備投資は、非常に旺盛であった昨年に比べ減少したものの、高い水準で継続しました。

このような事業環境において当社の精密加工装置は、昨年見られた大型の案件は無いもののメモリを中心に幅広い半導体用途で、精密加工のニーズが増えていることから、引き続き高い水準の出荷が続いております。また、消耗品である精密加工ツールは、半導体メーカの高い設備稼働率、世界の半導体生産数量の増加に比例して引き続き着実に増加していることから、売上は過去最高を更新し続けています。

損益は、昨年の非常に高い売上水準からの反動

減によって減益となりましたが、短期的な業績に左右されず、長期目線で積極的な研究開発活動を行ってまいります。

なお、中間配当金につきましては、配当方針に基づき業績連動により1株当たり114円とさせていただきます。

今後の見通し

今後もデータセンタ向けをはじめ、次世代通信である5G、自動運転技術、医療分野など、半導体・電子部品の需要拡大に伴い、顧客の「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」へのニーズは拡大し続けることが予想されます。そのため、生産拠点である広島県の桑畑工場は2019年1月末のCゾーン竣工

に加え、同年9月にはDゾーン建設への工事着工でさらなる拡張を進めるほか、第2の製造拠点として長野県の茅野工場の拡張を検討しております。

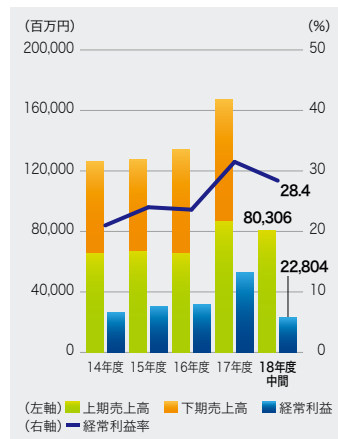
こうした事業面の強化に加え、組織面の強化として、良質な企業文化の醸成に注力し、社員一人ひとりが考えて行動できる仕組みづくりや進化・改善活動を継続してまいります。

ステークホルダーの皆様におかれましては一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

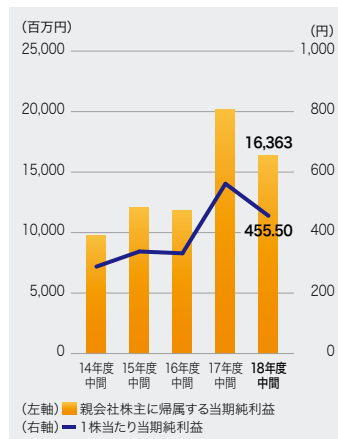


財務ハイライト

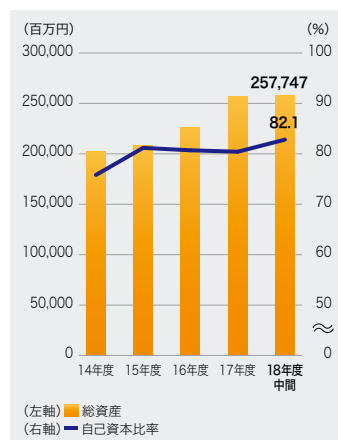
売上高・経常利益・経常利益率



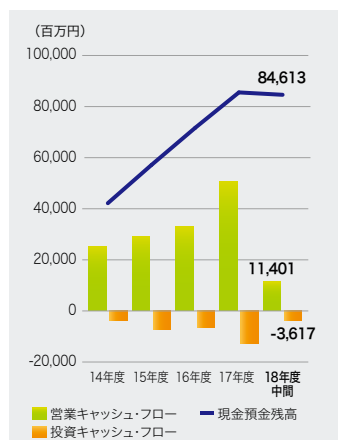
親会社株主に帰属する当期純利益・1株当たり当期純利益



総資産・自己資本比率



キャッシュ・フロー



当期の概況

当期(2018年4月1日から2018年9月30日まで)においては、メモリ向けを中心に幅広い用途で需要が強く、半導体メーカーの設備投資は比較的高い水準を維持しました。しかし、前年のような大型案件が無かったことにより、精密切断装置(ダイサ)と精密研削装置(グライнда)ともに売上は減少し、精密加工装置の売上高は、前年同期と比べ約1割減少しました。消耗品である精密加工ツールは、メーカー各社の高い設備稼働率に比例して高水準の出荷が続ぎ、売上高は前年同期並の高い水準となりました。

当期の損益は、主に製品構成の変化によりGP率が低下したことに加え、積極的な研究開発活動などにより販売管理費が増加したため、前年同期と比べ営業利益は減少しました。

以上の結果、当期の売上高 803億6百万円(前期比7.2%減)、営業利益 231億81百万円(同 19.8%減)／営業利益率 28.9%、経常利益 228億4百万円(同 20.3%減)／経常利益率 28.4%、親会社株主に帰属する四半期純利益 163億63百万円(同 18.8%減)／純利益率 20.4%となりました。

■財政状態

当期末の総資産は、前期末と比べ13億99百万円増加し、2,577億47百万円となりました。これは、原材料と売掛金が増加したことによるものです。負債は、前期末と比べ59億74百万円減少して451億7百万円となりました。これは、主に未払法人税や賞与引当金が減少したことによるものです。

純資産は、前期末から73億74百万円増加し2,126億

39百万円となり、自己資本比率は前期末比2.4ポイント増加し82.1%となりました。

■キャッシュ・フロー

営業活動では、114億1百万円の資金増加、投資活動では、36億17百万円の資金減少だったことからフリー・キャッシュ・フローは、77億84百万円の資金増加となりました。これは、売上高減少に伴う税金等調整前四半期純利益の減少や開発資産の増加や海外拠点の拡張などを含めた有形固定資産の取得などにより資金減少があったことによるものです。財務活動では、主に配当金の支払いによって88億98百万円の資金減少となりました。これらの結果、当期末の資金残高は、前期末から9億31百万円減少し、846億13百万円となりました。

2019年3月期第3四半期(累計)の連結業績予想

足元では引き続きメモリ向けを中心とした幅広い用途において需要は底堅く推移すると見込んでおります。

※半導体・電子部品業界において顧客の投資意欲が短期間で激しく変動することから需要予測が困難なため、今後の業績予想の開示方法については、これまでの「2四半期先までの開示」から「1四半期先までの開示」へと変更しています。

2019年3月期第3四半期(累計)の連結業績予想

売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
1,156億円	314億円	314億円	223億円	620.75円



ディスコの企業理念



「高度な**Kiru・Kezuru・Migaku**技術によって
遠い科学を身近な快適につなぐ」

3つのコア技術を深めることで、ディスコは産業と暮らしに貢献していきます。

「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」とは

ディスコのビジネステーマを指しています。人類に欠かせない普遍的な技術である「切る」「削る」「磨く」という事業領域において、ディスコは世界のオンリーワン企業でありたいと考えています。あえてローマ字で表記しているのは、これらの分野でディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという、強い思いが込められているからです。

「遠い科学を身近な快適につなぐ」とは

ディスコの社会的使命(ミッション)を意味しています。日々進歩していく科学技術を、ディスコの「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」によって、人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたい、という考えを表現しています。

ディスコが追い求める成長とは

企業の成長をどのように定義するかによって、経営の方向性は大きく変わります。ディスコの「成長」とは売上やシェア、規模の拡大などに依らず、2つの基準によって評価されています。ひとつはミッションの実現度が高まり、社会により大きく貢献ができていくか、もうひとつはお客様・従業員・サプライヤ・株主など、すべてのステークホルダとの価値交換性が向上しているか、です。